

TGVI 高速 T/ROSA OE

产品介绍

TGVI 高速 T/ROSA OE 产品基于深光谷自研 TGV 光电 interposer 芯片，通过激光诱导、深硅刻蚀技术，重布线（RDL）和微凸点工艺实现基于玻璃基板的光电芯片封装互连和光电信号转换；自研 TGV interposer 芯片可实现 110GHz 以上布线带宽，显著提升了信号传输效率和密度；匹配市场主流硅光调制芯片和电驱动芯片，实现 4/8 通道标准化方案集成，同时兼容主流硅光芯片与电芯片的管脚定义，实现光电混合封装的高度集成化；片上可集成激光直写波导与 interposer 内开槽结构，可支持与 FAU、MT 插芯、MCF 等低损耗耦合，实现高密度的光路扇入扇出。

性能特点：

- 模组高度集成化，客制化
- RDL 和微凸点工艺，支持布线带宽 > 110GHz
- 支持光电芯片 2.5D/3D 封装
- 支持低损耗光波导激光直写
- 支持立体结构开槽，支持低损耗高密度光耦合

关键参数指标：

性能参数	范围
OE 模组尺寸（不含 FA 等）	5mm×9mm
interposer 玻璃厚度	260μm
布线带宽	> 110GHz
TGV 孔开口	60μm—25μm
RDL 线宽线距	80μm-15μm
RDL 厚度	3μm

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 1 栋 1202 室

座机：+86-755-84652252

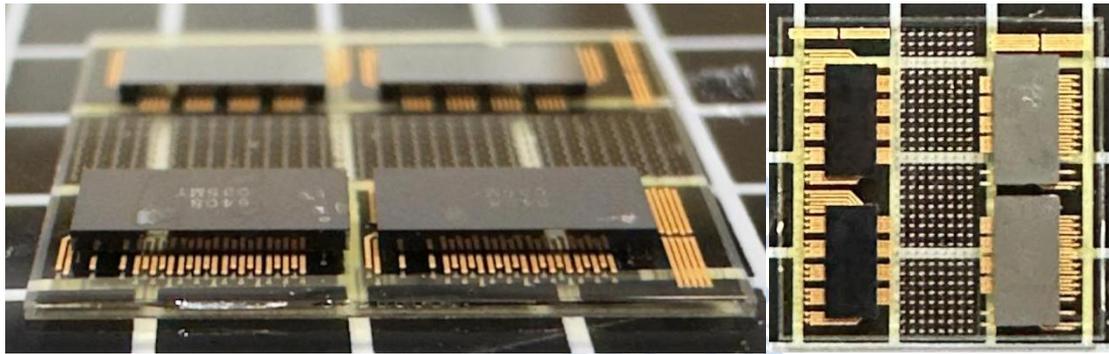
联系电话：+86-189 4877 6698

邮件：info@photonicsv.com

网址：<https://www.photonicsv.com>

PI 厚度	5 μ m
Bump 球径	60 μ m
通道速率	>110G

TGV T/ROSA OE 应用 示意图:



地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 1 栋 1202 室

座机：+86-755-84652252

联系电话：+86-189 4877 6698

邮件：info@photonicsv.com

网址：<https://www.photonicsv.com>